

Dk 3.36 Df 0.0029 @13GHz

Tg (DMA) 250°C

T320(銅付) >120分

用途
ネットワーク/ワイヤレス通信
 ICTインフラ機器、高速通信機器(ハイエンドサーバ、ルータ、光ネットワーク、スイッチ)、高多層基板 など



Halogen-free
MEGTRON6

Laminate

R-537Y(N)* R-537Y(E)

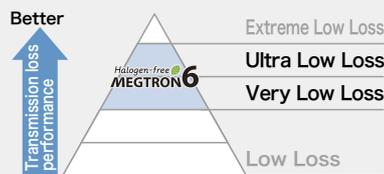
Prepreg

R-527Y(N)* R-527Y(E)

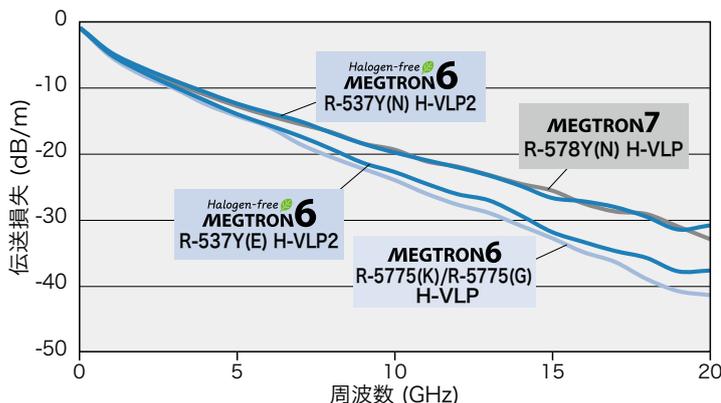
*Low Dk glass cloth type

ハロゲンフリー超低伝送損失多層基板材料

超高性能サーバやルータ向けのデファクトスタンダード材料にハロゲンフリーを付与。MEGTRON6を超える低伝送ロスを実現し、超高性能サーバやルータの性能向上に貢献



伝送損失比較



高多層耐熱性

評価結果

ドリル径	φ0.3mm	
TH壁間距離	0.3mm	0.5mm
Halogen-free MEGTRON6 R-537Y(E)	pass	pass

評価条件

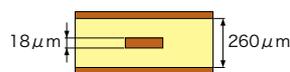
260°Cリフロー×10回

構成

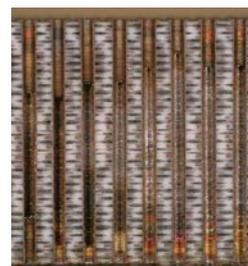
32層

板厚: 4.5mm

構成



配線長さ	200mm, 100mm
配線幅	125μm
インピーダンス	50Ω
内層銅箔処理	表面処理なし
コア材	0.13mm
プリプレグ	#2116 56% x 1ply



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	Halogen-free MEGTRON6 R-537Y(N) Low Dk glass cloth	Halogen-free MEGTRON6 R-537Y(E) E glass cloth	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) E glass cloth	
ガラス転移温度(Tg)	DMA (1Hz)	A	°C	250	250	210*1	
熱膨張係数(厚さ方向)	$\alpha 1/\alpha 2$	IPC TM-650 2.4.24	ppm/°C	39/200	39/200	45/260	
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	>120	
T320(銅付)				>120	>120	50	
比誘電率(Dk)	13GHz	平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.36	3.66	3.62
誘電正接(Df)					0.0029	0.0037	0.0046
銅箔引き剥がし強さ	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.6*2	0.6*2	0.8*3

試験片の厚さは0.75mmです。

※1 10Hz ※2 H-VLP2銅箔 ※3 H-VLP銅箔

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry Halogen-free MEGTRON6